

表面保護用フィルム事業の譲渡に関するお知らせ

株式会社レゾナック（社長：高橋 秀仁、以下、「当社」）は、2024年8月7日付で、表面保護用フィルム事業（以下、「本事業」）を株式会社サンエー化研（社長：櫻田武志、以下、「サンエー化研」）に譲渡する契約を締結し、2024年11月15日にクロージングを実行いたしました（以下、「本譲渡」）。今後、本事業に係る各契約を順次サンエー化研に承継いたします。詳細について下記の通りお知らせいたします。

記

1. 検討の背景と目的

表面保護用フィルム事業は、旧日立化成株式会社時代の1967年に操業を開始し、半導体リードフレームめっき保護用途をはじめ、お客様のニーズに応じた様々な用途の保護フィルムを開発・選定・提案してきました。一方で、保護フィルム業界は市場の成熟期にあり、近年のマクロ環境や原材料価格、エネルギー価格の高騰などから、当社グループにおいては、本事業の今後の大きな成長や他事業とのシナジーが見込みにくい状況となっていました。

当社グループは、「統合新会社の長期ビジョン(2021～2030)」で示した通り、世界トップクラスの機能性化学メーカーとして、持続可能な社会への貢献を目指しています。その実現に向けて、継続的にポートフォリオの見直しをはかることで、持続的な成長を追求しています。

このビジョンに基づき、最適な経営資源の配分および事業ポートフォリオマネジメントを検討する中で、本事業の在り方について、あらゆる選択肢を慎重に検討しました。その結果、国内屈指のプラスチックフィルム加工メーカーであるサンエー化研のもとで事業拡大を図ることが、当社の取引先様、当社の関連製品を日々ご利用いただいている最終消費者の皆様および各ステークホルダーにとって最適であると判断し、本譲渡を推進することを決定いたしました。表面保護用フィルムの製造販売に実績のあるサンエー化研と一体となって、積極的かつ戦略的に事業を推進していくことにより、さらなる成長と競争力の強化が実現できるものと確信しています。

なお、本譲渡による当社業績への影響は軽微と見込んでいます。

2. 事業譲渡の概要

(1) 対象事業

表面保護用フィルム

(2) 譲渡対象

契約、特許権、技術ノウハウ、一部設備（従業員は含まない）

(3) 譲渡契約締結日

2024年8月7日

(4) クロージング日

2024年11月15日

3. 譲渡先の概要

名称	株式会社サンエー化研
本社所在地	東京都中央区日本橋本町1丁目7番4号
営業所所在地	本社
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 櫻田武志
事業内容	紙、プラスチック、金属箔等を主原料とする軽包装資材、剥離紙、粘着テープ基材、表面保護フィルム等、包装材料関連製品の製造・販売
資本金	21億76百万円
設立年月日	1942年9月2日
大株主および持株比率	新生紙パルプ商事株式会社 17.8%、昭和パックス株式会社 11.8%

以上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカル等を展開し、川中から川下まで幅広い素材・先端材料テクノロジーを持つ化学会社です。2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合し、新たなスタートを切りました。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistryの「C」を組み合わせて生まれました。レゾナックは「共創型化学会社」として、共創を通じて持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。2023年度の売上高は約1兆3千億円、うち海外売上高が53%を占め、世界22の国や地域にある製造・販売拠点でグローバルに事業を展開しています(2024年2月時点)。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ TEL 03-6263-8002